

**Azterketa: PROZESUAK**

**Izena:**

**Kurtsoa:**

**Adierazi TORNU PARALELOARI buruzko esaldiak zuzenak ala okerrak diren PUNTUAZIOA: 2 PUNTU**

- Herraminta gisa diamantea erabil daiteke
- Karburoak ere erabil daitezke herraminta gisa
- Pieza baten gaineko eragiketak zehazterakoan abiadura angeluarra eman behar da
- Herramintak biraketa-higidura egiten du
- Tornu paraleloan piezaren aurpegia leundu daiteke
- Tornu paraleloan materiaren murrizketa ematen da
- Prozesua CNC-ren bitartez kontrolatzen denean programa ordenadore-zerbitzarian gordetzea interesgarria da
- Material zeramikoak egokiak dira tornu paraleloan erabiltzeko (piezak egiteko)
- Piezari zuloa egiten zaionean (erditik) ez da bero handirik askatzen eta likido hoztailerik ez da behar
- Pieza luzeen prozesuan, zailtasunak agertzen dira; pieza motzak errazago lantzen dira

**Adierazi FRESAKETARI buruzko esaldiak zuzenak ala okerrak diren PUNTUAZIOA: 2 PUNTU**

- CNC programazioan posizio erlatiboak erabili behar dira nahitaez
- Herramintak egiten duen angelua 90<sup>o</sup>-koa baino handiagoa izan behar du, txirbilak hobeto kanporatzeko
- Herramintak duen forma txirbila eliminatzeko eta apurtzeko egokitzen da
- Fresaketan bi herraminta batera erabil daitezke eta beraien arteko distantzia kontrolatu
- Pieza baten azalera leuntzeko erabil daiteke fresaketa
- Hoztailea erabiltzen ez bada, azalera leunagoa geratzen da
- Tresnak bost higidura ezberdin izan dezake
- Bi eratakoak daude: bertikalak eta horizontalak
- Piezak seriean egin aurretik prototipoa egitea ez du merezi
- Piezaren posizioa R, S eta T aldagaien bidez adierazten da

**Adierazi BESTE ERAGIKETARI buruzko esaldiak zuzenak ala okerrak diren**  
**PUNTUAZIOA: 2 PUNTU**

- Xaflaren lodiera gutxitzeko metodo kimikoak erabiltzen dira
- Metodo kimikoak industria aeronautikoan erabiltzen da askotan
- Metodo fotokimikoak erabiliz oso pieza txikiak eta konplexuak egin daitezke
- Prozesu elektrokimikoan pieza sortzeko elektrodoak erabiltzen da
- EDM prozesuan deskarga elektrikoak sortzen dira
- EDM prozesuan fluido dielektrikoa erabiltzen da hoztailea gisa, besteak beste
- LBM prozesuan X izpiak askatzen dira
- EBM arriskutsua eta garestia denez, askotan LBM prozesua erabiltzen da
- Material zeramikoak lantzeko egokiagoa da tornu paraleloa LBM metodoa baino
- CM prozesuan sodio hidroxidoa erabil daiteke

**Adierazi SOLDAKETARI eta EBAKETARI buruzko esaldiak zuzenak ala okerrak diren**  
**PUNTUAZIOA: 2 PUNTU**

- Prozesu oxiazetilenikoarekin pieza bat ebaki aurretik berotu egin behar da
- Garra oxidatzailea da soldatzeko egokiena (prozesu oxiazetilenikoaren kasuan)
- Gas inertearen funtzio nagusia prozesuaren tenperatura ez handitzea da
- Gas inerte erabiliena tungstenoa da
- Elektrodoak kontsumitzen denean arku elektrikoa uniformeagoa lortzen da prozesuan
- Soldaketa eman daiteke elektrodorik kontsumitu gabe
- Plasma lortzeko potentzial elektrikoa (boltajea) behar da
- Soldatutako eskualdean piezaren gogortasuna aldatu egiten da
- Metalen mikroegitura aldatu egiten da tenpereturekin
- Garra erreduktorea (prozesu oxiazetilenikoa) soldaketaren tenperatura igotzeko erabiltzen da